【编号S011】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成果名称 | 电路板绿色拆解及焊锡高效回收技术 | | |
| 完成单位 | 清华大学 | | |
| 成果简介 | 综合介绍：近年来，废旧家电拆解产生大量的废电路板，由于其含有丰富的铜、锡、金、银等贵重金属，电路板的回收成为目前的电子废物循环产业领域关注的重点。对于废电路板的无害化及资源化研究，废电子元器件的高效剥离、焊锡的回收是当前产业面临的瓶颈之一。尽管目前存在针对废电子元器件的手工拆解、机械拆解、甚至高温焊锡拆解，但存在焊锡得不到回收、拆解效率低、二次污染大等问题。因此亟待筛选高度稳定性的加热介质，满足高温下不易发生氧化反应，也不易于金属发生化学反应，沸点高，高温不挥发且无毒等条件，同时重点考虑加热介质的循环利用特征。 | | |
| 技术指标：  高效回收金属焊锡，避免混入后续工艺带来污染；   热介质离子液体加热过程可控性好，减少电路板处理过程污染物的释放；   热介质离子液体可重复使用。 | | |
| 成果成熟度 | □研制阶段 □试生产 ■小批量生产 □批量生产 □其它 | | |
| 合作方式 | ■技术开发 □技术入股 ■技术转让 □技术服务 □技术咨询  □人才培养 □共建载体 □其它 | | |
| 成果完成人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 | 李宁 | 联系电话 | 010-62771822 |
| 电子邮箱 |  | 手机号码 |  |